

大型パネル用 レーザー剥離装置

SELD-LASER Series



大型パネルのガラス剥離を高速で！

装置概要

本装置は、レーザー照射によって、ストレス無くデバイスから支持用ガラスを剥離する装置です。

特徴

デバイスへのダメージ低減

レーザーの波長は355nmです。波長が短いため、剥離する樹脂層のごく表層でレーザーエネルギーが吸収されます。よって、レーザーによるデバイスダメージを防ぐことが可能です。

大型パネル対応

600mm×600mmまでのパネルに対応しています。

高速剥離

高速スキャナシステムの採用で、従来品のスキャナシステムと比較して高速照射を実現しました。

反りに強い

高さ方向の変化に対して安定※したビームにより、反りのあるワークも安定して剥離することが可能です。

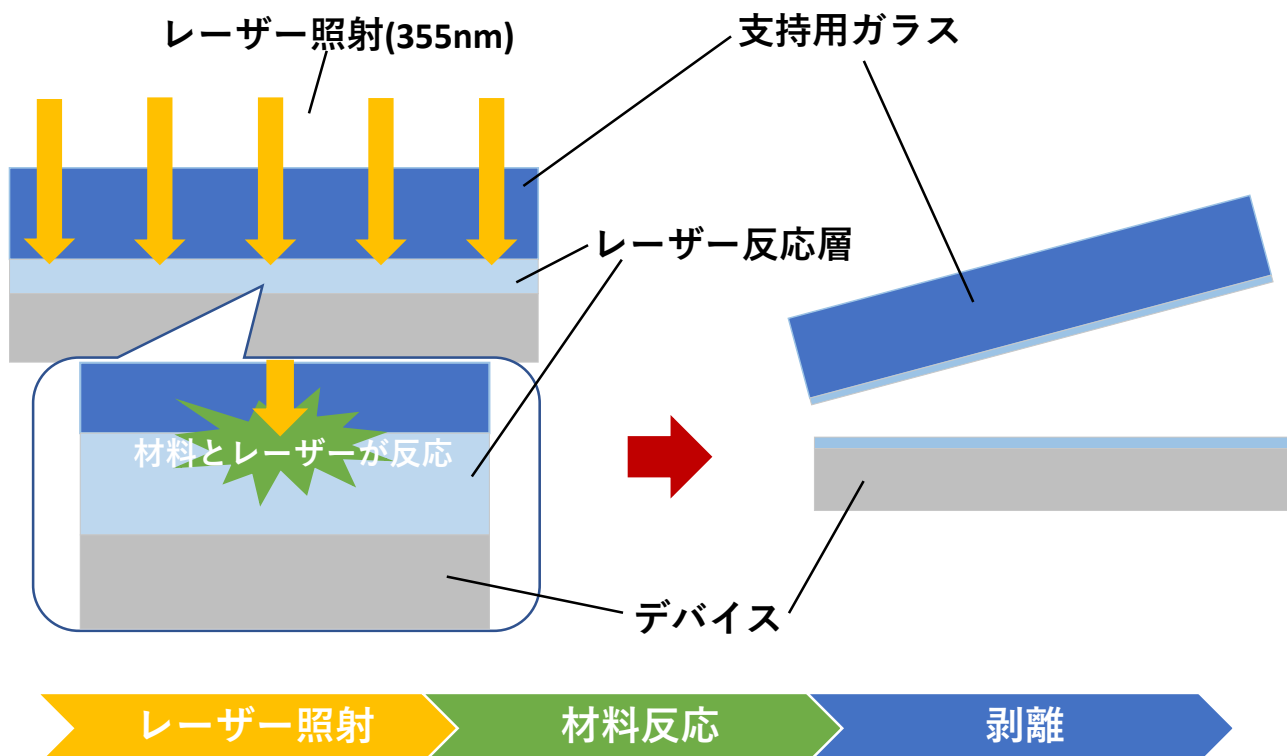
※安定とは、ビームの形状と大きさ、エネルギー密度の均一性を意味します。

レーザー照射後のスス対策

集塵システムの導入により、加工時に発生する煤が装置内に飛散しません。装置の摺動部分への侵入を低減します。

※レーザー剥離技術について、IBMよりライセンス取得済み※

洗浄フロー(モデルケース)



仕様

基本装置構成	レーザー発振器、スキャナ、ワークステージ、チラー、集塵機
波長	355nm(UVレーザー)
スキャン速度	>20m/s
対応可能ワークサイズ	パネルサイズ：600×600mm以下 ウェハサイズ：φ300mm以下

ShinEtsu

信越エンジニアリング株式会社
Shin-Etsu Engineering Co.,Ltd.

システム機器部

Electro-Mechanics Division

〒379-0127 群馬県安中市磯部2-2-45

2-45, Isobe 2-chome, Annaka-shi, Gunma, 379-0127, Japan

担当：大谷 義和 (systeminfo@see.jp)

Person in charge : Yoshikazu Otani (systeminfo@see.jp)

TEL : 027-384-5720

+81-27-384-5720

FAX : 027-384-5735

+81-27-384-5735